

令和元(2019)年度 基盤研究 (S) 審査結果の所見

研究課題名	革新的負熱膨張材料を用いた熱膨張制御
研究代表者	東 正樹 (東京工業大学・科学技術創成研究院・教授) ※令和元(2019)年7月末現在
研究期間	令和元(2019)年度～令和5(2023)年度
科学研究費委員会審査・評価第二部会における所見	<p>本研究は、負の熱膨張係数を持つペロブスカイト化合物をフィラーとして高分子材料と複合化し、実質的に熱膨張率が「0(ゼロ)」となる材料を広い温度範囲で開発することを目標としている。</p> <p>負熱膨張メカニズムの理解という学術的意義に加え、本研究の目的が達成された場合における産業応用の観点からの波及効果も極めて大きい。本研究の成果は、先端デバイスの信頼性が要求されるものにも適用できる重要技術へと発展する可能性がある。</p>